

PRODUCT No.	No. OF CONTACTS
59453-041110EDHLF	4 CONTACTS
59453-051110EDHLF	5 CONTACTS
59453-061110EDHLF	6 CONTACTS
59453-071110EDHLF	7 CONTACTS
59453-081110EDHLF	8 CONTACTS
59453-091110EDHLF	9 CONTACTS
59453-121110EDHLF	12 CONTACTS
59453-131110EDHLF	13 CONTACTS

A

B

C

D

E

F

2

3

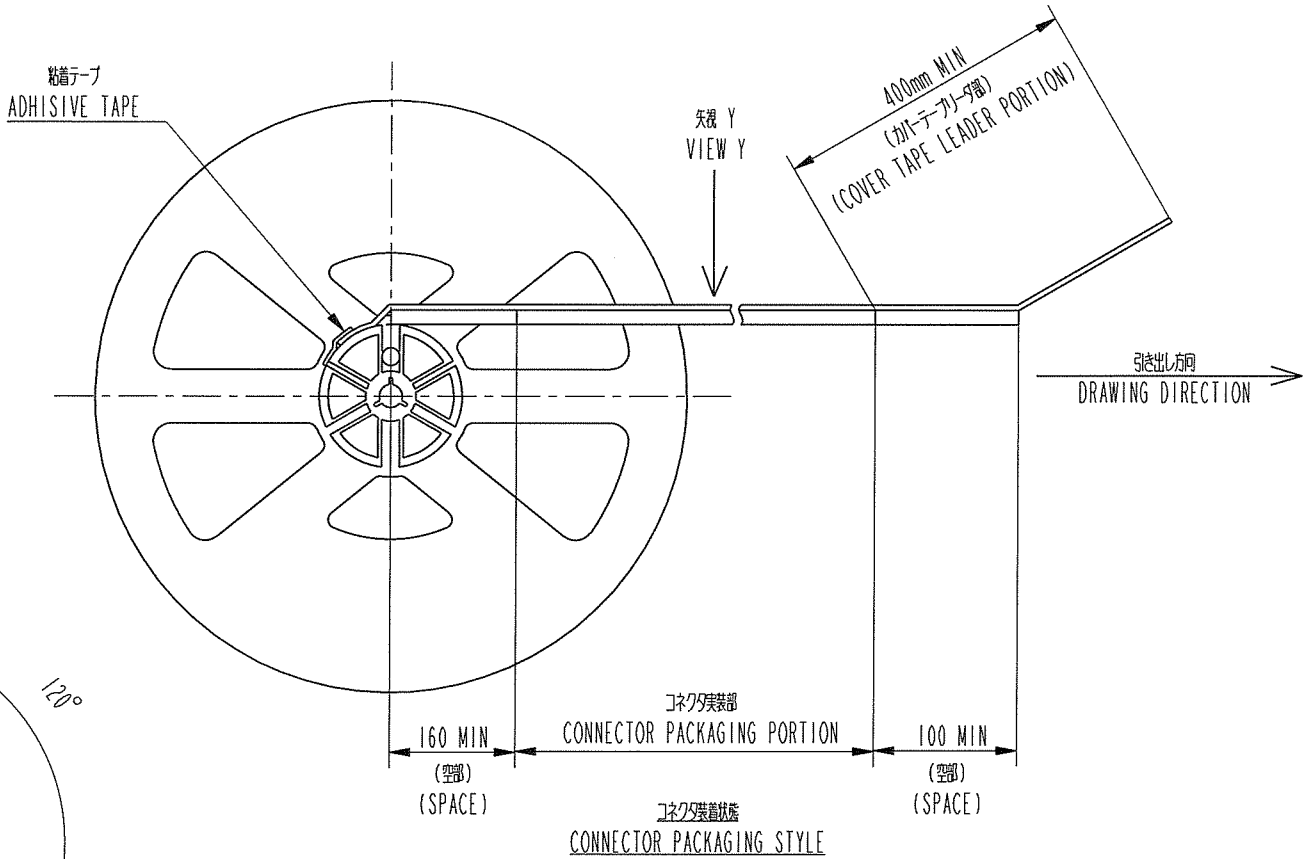
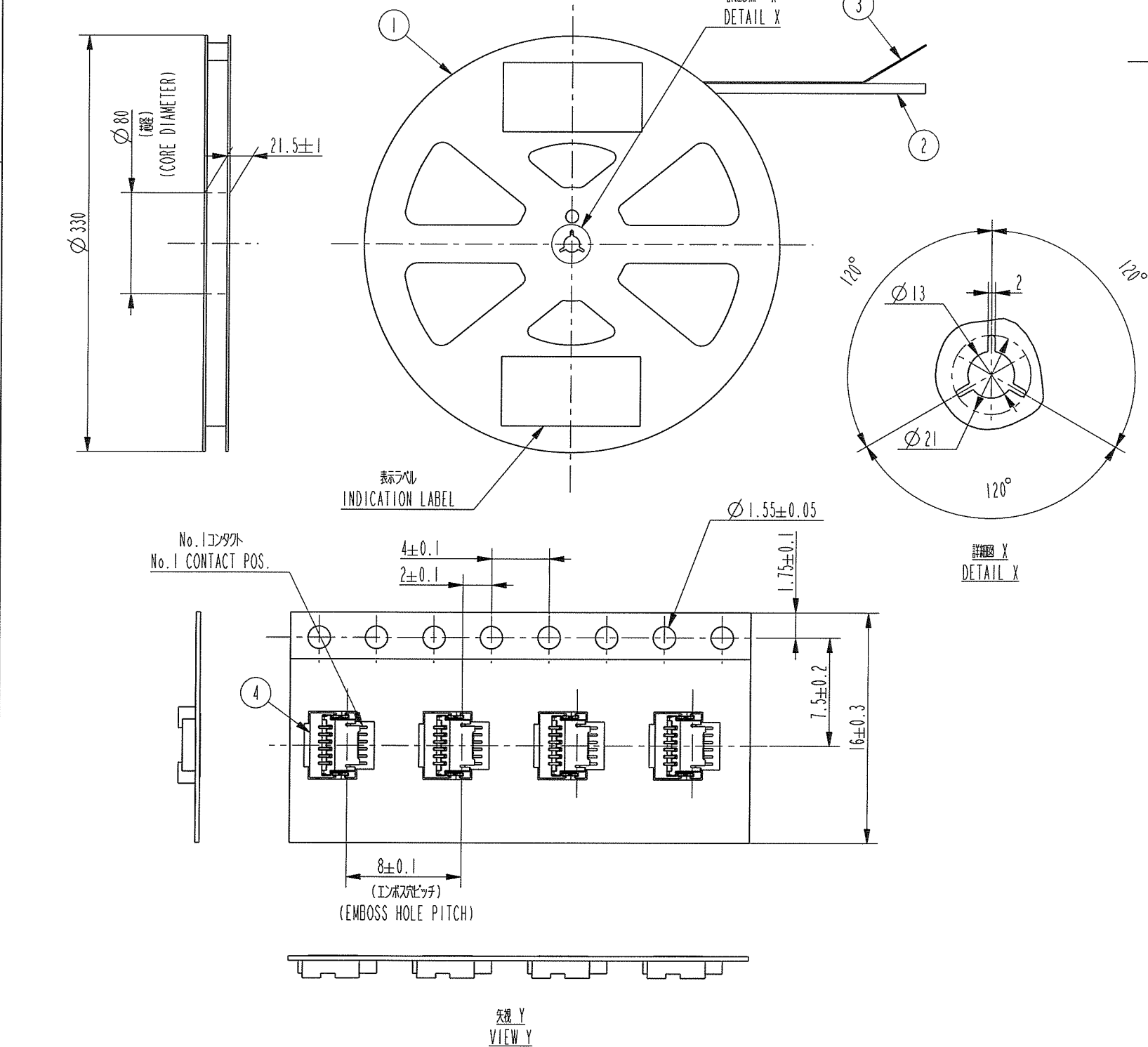
4

5

6

7

8



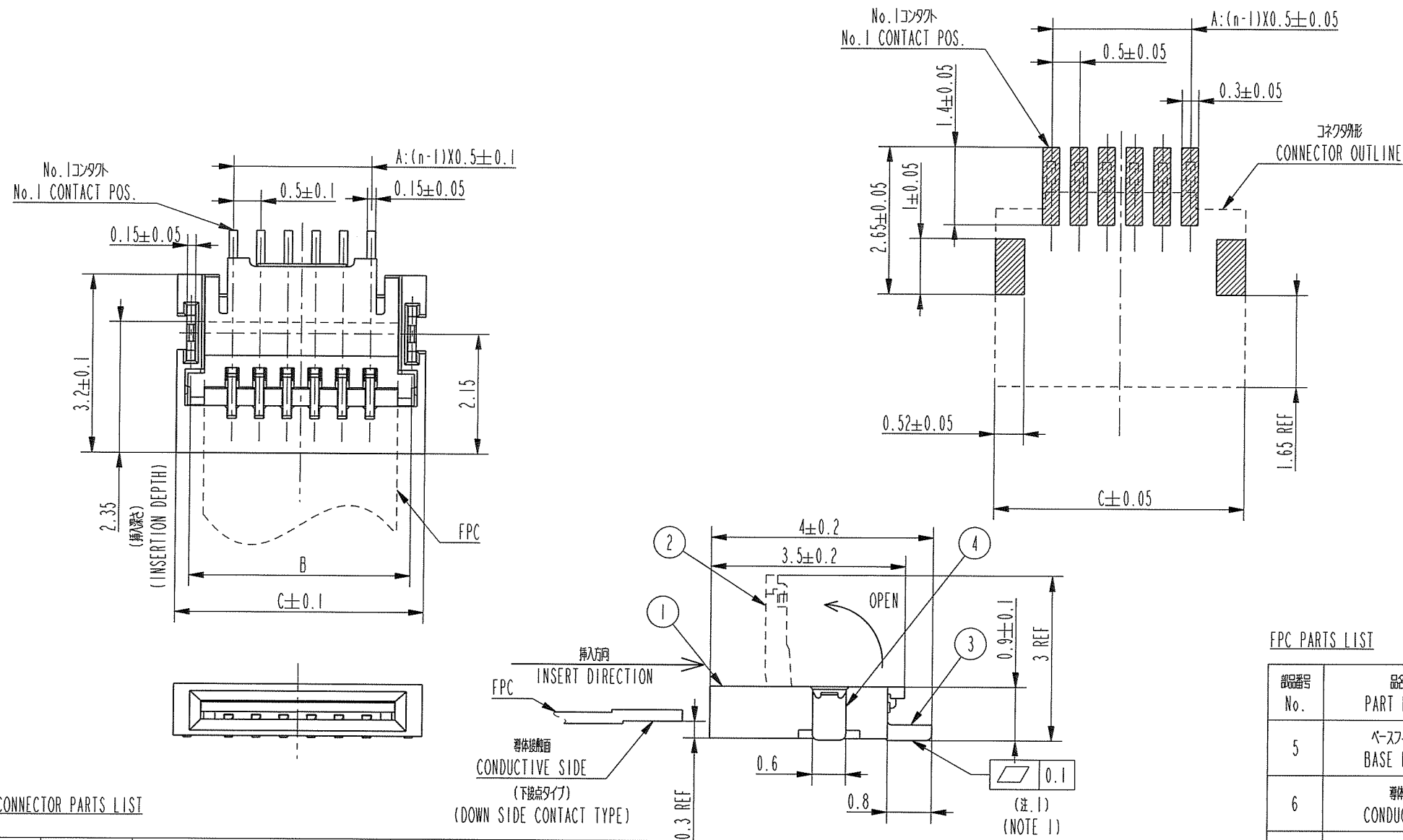
部番 No.	品名 PART NAME	型番 PRODUCT No.	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	記事 NOTE
1	リール REEL	-----	ポリスチレン POLYSTYRENE	1	色: 白, 帯電防止 COLER: WHITE, ANTI STATIC
2	プラスチック(エンボス)テープ PLASTIC(EMBOS)TAPE	-----	PP又は, PET PP or PET	1	帯電防止 ANTI STATIC
3	カバーテープ COVER TAPE	-----	ポリエステル POLYESTER	1	
4	コネクタ(単体) CONNECTOR	59453-...111DHLF	添付図面参照 SEE ATTACHED DRAWING	5,000	接点部: 金めっき CONTACT AREA PLATING: GOLD ターミナル部: 金めっき TERMINAL AREA PLATING: GOLD

注記
 1. 本製品は、自動実装(SMT)対応、FPC用コネクタのプラスチックテープ梱包品である。
 2. プラスチック(エンボス)テープ及びリールの形状寸法は、JIS C 0806(電子部品のテーピング)(表面実装部品)に準ずる。
 NOTE
 1. THIS IS PLASTIC TAPE PACKAGED CONNECTOR USED FPR FPC AND COPES WITH AUTOMATIC MOUNTING(SMT)
 2. SEE JIS C 0806 (PACKING OF ELECTRONIC COMPONENTS ON CONTINUOUS TAPES (SURFACE MOUNTING DEVICES))

rev	ecn no	dr	date
A	J08-0218	M.K	May. 21 '08
B	J08-0406	M.K	Oct. 15 '08
C	J09-0292	M.K	Aug. 06 '09
D	J10-0179	M.K	July 1, '10

www.fciconnect.com			surface 		tolerance std		projection 		MM 	
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							
Dr	<i>T. Sakakura</i>	<i>July 1, '10</i>	ANGULAR	LINEAR			size	A2	Scale N/A	
Eng	<i>M. Higo</i>	<i>July 1, '10</i>			±5					
Chr	<i>M. Higo</i>	<i>July 1, '10</i>			5° ±°			ECN	J10-0179	
Appr	<i>M. Higo</i>	<i>July 1, '10</i>	Product family 59Cf				Spec ref			
	title	PLASTIC TAPE PACKAGED 0.5mm PITCH FPC CONNECTOR					dwg no	59453		Rev. D
		(下接点タイプ/DOWN SIDE CONTACT TYPE)								
		catalog no								
		CUSTOMER								

推奨基板パターン図
RECOMMENDED PCB LAYOUT



CONNECTOR PARTS LIST

部品番号 No.	部品名 PART NAME	材料 MATERIAL	数量 Q'TY	記事 NOTE
1	ハウジング HOUSING	ガラス繊維入り熱可塑性樹脂 UL94V-0	1	色:黒 ハロゲンフリー COLOR:BLACK Halogen Free
2	アクチュエータ ACTUATOR	ガラス繊維入り熱可塑性樹脂 UL94V-0	1	色:黒 ハロゲンフリー COLOR:BRACK Halogen Free
3	コンタクト CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	n	接点部:金めっき CONTACT AREA PLATING:GOLD 端子部:金めっき TERMINAL AREA PLATING:GOLD
4	補強金具 FIXING TAB	黄銅 BRASS	2	めっき:銅めっき(鉛フリー) PLATING:TIN(LEAD FREE)

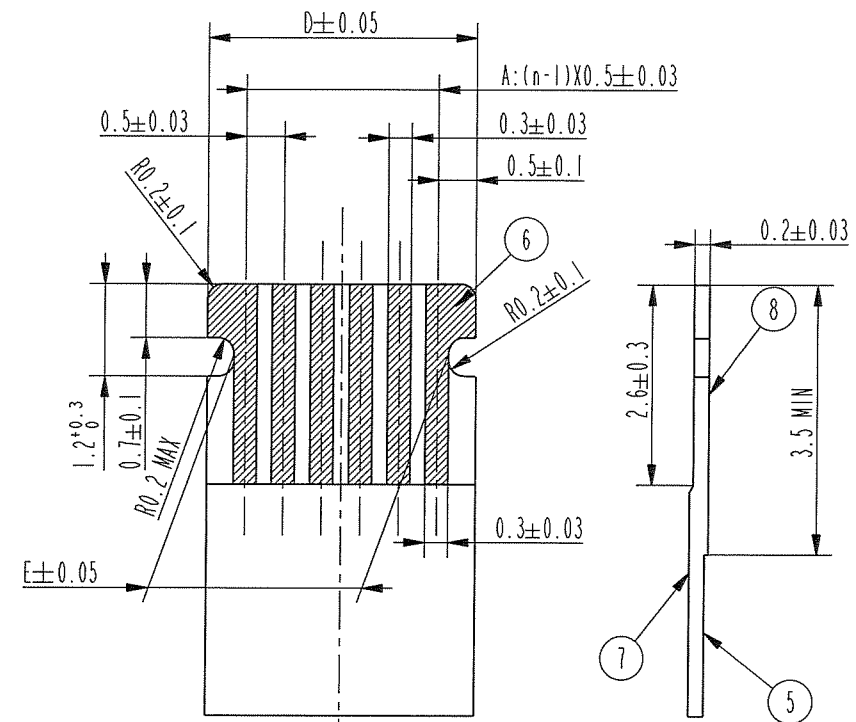
注記
1. コンタクト、補強金具の平坦度は、0.1以内
NOTE
1. COPLANARITY FOR CONTACT TERMINAL AND FIXING TAB MUST BE WITHIN 0.1mm.
2. 本製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ指令と他国の規格に適合しています。
2. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.

n=No. OF CONTACTS

PRODUCT No. AND DIMENSIONS

PRODUCT No. (Not emboss packaging)	DIMENSIONS				
	A	B	C	D	E
59453-04111DHLF(4 CONTACTS)	1.5	3.0	3.5	2.5	1.8
59453-05111DHLF(5 CONTACTS)	2.0	3.5	4.0	3.0	2.3
59453-06111DHLF(6 CONTACTS)	2.5	4.0	4.5	3.5	2.8
59453-07111DHLF(7 CONTACTS)	3.0	4.5	5.0	4.0	3.3
59453-08111DHLF(8 CONTACTS)	3.5	5.0	5.5	4.5	3.8
59453-09111DHLF(9 CONTACTS)	4.0	5.5	6.0	5.0	4.3
59453-12111DHLF(12 CONTACTS)	5.5	7.0	7.5	6.5	5.8
59453-13111DHLF(13 CONTACTS)	6.0	7.5	8.0	7.0	6.3

推奨FPC寸法
RECOMMENDED FPC



FPC PARTS LIST

部品番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	記事 NOTE
5	ベースフィルム BASE FILM	ポリイミド POLYIMIDE	
6	導体 CONDUCTOR	銅箔 金めっき 0.1μm以上 COPPER FOIL(PLATING:GOLD 0.1μm)	
7	オーバーレイ OVER LAY	ポリイミド POLYIMIDE	
8	補強板 SUPPORTING TAPE	ポリイミド POLYIMIDE	

注記
熱硬化接着剤を使用し、接着方式は熱圧着とする。

NOTE
ADHISIVE METHOD OF SUPPORTING TAPE SHALL BE HEAT CRIMPING METHOD AND THERMOSETTING ADHISIVE SHALL BE USED

www.fciconnect.com				surface 		tolerance std		projection 		MM 																			
				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED																									
Dr		B. Fujimura		July 1, '10		ANGULAR		LINEAR				size		A2		Scale													
Eng		M. Higa		July 1, '10						±0.3						N/A													
Chr		M. Higa		July 1, '10		3° ±°						ECN		J10-0179															
Appr		M. Higa		July 1, '10		Product family				59CF				Spec ref															
		title										0.5mm PITCH FPC CONNECTOR										dwg no		59453		Rev.			
												(下接点タイプ/DOWN SIDE CONTACT TYPE)																	
		catalog no																				CUSTOMER				sheet 2 of 2			
rev		ecn no		dr		date																							
A		J08-0218		M.K		May. 21 '08																							
B		J08-0406		M.K		Oct. 15 '08																							
C		J09-0292		M.K		Aug. 06 '09																							
D		J10-0179		M.K		July 1, '10																							